



Board Type Rigid

Board structure Standard

Materials FR4

Layers 4

Laminations 1

RIGID PART Total Thickness 1,610 mm

#	Definition	Type	Thickness
	Soldermask	SM = 0,015 mm	0,015
1	Copper	CU 35 um	0,035
	Prepreg	PP FR4 = 0,120 mm	0,12
2	Copper	CU 35 um	0,035
	CORE	IL 1,20	1,2
3	Copper	CU 35 um	0,035
	Prepreg	PP FR4 = 0,120 mm	0,12
4	Copper	CU 35 um	0,035
	Soldermask	SM = 0,015 mm	0,015